(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 4. Juli 2002 (04.07.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 02/052634 A2

(51) Internationale Patentklassifikation7:

H01L 21/66

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE01/04903

(22) Internationales Anmeldedatum:

27. Dezember 2001 (27.12.2001)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

100 65 380.4 27. Dezember 2000 (27.12.2000) DE

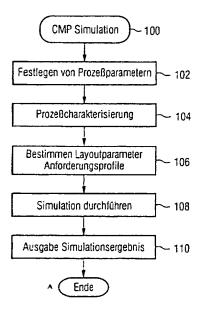
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St.-Martin-Strasse 53, 81669 München (DE).

- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): DICKENSCHEID, Wolfgang [DE/DE]; Loebauer Strasse 3, 01099 Dresden (DE). MEYER, Frank [DE/DE]; Conradstrasse 20, 01097 Dresden (DE). DELAGE, Stéphanie [FR/DE]; Altersheimer Strasse 9a. 81545 München (DE). SPRINGER, Götz [DE/DE]; Weissenberger Strasse 9, 01324 Dresden (DE).
- (74) Anwalt: EPPING HERMANN & FISCHER; Ridlestrasse 55, 80339 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): JP, KR, US.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR CHARACTERISING AND SIMULATING A CHEMICAL-MECHANICAL POLISHING PROCESS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR CHARAKTERISIERUNG UND SIMULATION EINES CHEMISCH-MECHANISCHEN POLIER-PROZESSES



- 100 CMP SIMULATION
- 2 DETERMINATION OF PROCESS PARAMETERS
- 04 PROCESS CHARACTERISATION
- 106 DETERMINATION OF LAYOUT PARAMETERS
 REQUIREMENT PROFILE
- 108 CARRY OUT SIMULATION
- 110 OUTPUT SIMULATION RESULT
- A END

- (57) Abstract: The invention relates to a method for characterising and simulating a CMP process, according to which a substrate to be polished, in particular a semiconductor wafer is pressed onto a polishing cloth and rotated in relation to the latter for a specified polishing period. Said method comprises the following steps: a) determination of a set of process parameters, in particular of the contact force and the relative rotational speed of the substrate and the polishing cloth; b) provision and characterisation of a test substrate comprising test patterns with different structural thicknesses for the specified process parameters; c) determination of a set of model parameters for simulating the CMP process from the results of the characterisation of the test substrate; d) determination of layout parameters of the substrate to be polished; e) determination of a requirement profile relative to the CMP process result for the substrate to be polished; and f) simulation of the CMP processes for determining the polishing period necessary to fulfil the requirement profile. The invention also relates to a method for operating a test device for semi-conductor components.
- (57) Zusammenfassung: Ein Verfahren zur Charakterisierung und Simulation eines CMP-Prozesses, bei dem ein zu polierendes Substrat, insbesondere ein Halbleiterwafer, auf ein Poliertuch gedrückt und relativ zu diesem für eine bestimmte Polierzeit rotiert wird. umfaßt die Verfahrensschritte: a) Festlegen eines Satzes von Prozeßparametern, insbesondere von Andruckkraft und relativer Rotationsgeschwindigkeit von Substrat und Poliertuch, b) Bereitstellen und Charakterisieren eines Testsubstrats mit Testmustern mit unterschiedlichen Strukturdichten bei den festgelegten Prozeßparametern; c) Bestimmen eines Satzes von Modellparametern zur Simulation des CMP-Prozesses aus den Ergebnissen der Charakterisierung des Testsubstrats; d) Bestimmen von Layoutparametern des zu polierendes Substrats; e) Festlegen eines Anforderungsprofils an das CMP-Prozeßergebnis für das zu polierende Substrat; und f) Simulieren des CMP-Prozesses zur Bestimmung der zur Erfüllung des Anforderungsprofils erforderlichen Polierzeit. Verfahren zum Betrieb einer Testvorrichtung für Halbleiterbauelemente.

WO 02/052634 A2

Veröffentlicht:

 ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Docket #<u>P2000, Q36 (</u>

Applic. #

Applicant: W. Didousdeid

Lerner and Greenberg, P.A. A w. Post Office Box 2480
Hollywood, FL 33022-2480

Tel: (954) 925-1100 Fax: (954) 925-1101

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts P2000,0361 WO N			ie Übermittlung des internationalen omnblatt PCT/ISA/220) sowle, soweit ider Punkt 5	
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum		(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jah	
PCT/DE 01/04903	(Tag/MonaVJahr) 27/12/2001		27/12/2000	
Anmelder				
INFINEON TECHNOLOGIES AG				
Dieser Internationale Recherchenbericht wurd Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem In			rstellt und wird dem Anmelder gemäß	
Dieser Internationale Recherchenbericht umfa [X] Darüber hinaus liegt Ihm jew		Blätter. esem Bericht genannten	Unterlagen zum Stand der Technik bei.	
Grundlage des Berichts				
 a. Hinsichtlich der Sprache ist die Inte durchgeführt worden, in der sie eing 				
Die Internationale Recherch Anmeldung (Regel 23.1 b))		einer bei der Behörde eir	ngereichten Übersetzung der internationalen	
Recherche auf der Grundlage des S	Sequenzprotokolis durch	gefühn worden, das	Aminosāuresequenz ist die internationale	
in der Internationalen Anme zusammen mit der internationalen	•		neteicht worden ist	
bei der Sehörde nachträglic			gereione worden ide.	
bei der Behörde nachträglic	_		st.	
Die Erklärung, daß das nac Internationalen Anmeldung			oll nicht über den Offenbarungsgehalt der gt.	
Die Erklärung, daß die in co wurde vorgelegt.	omputeriesbarer Form er	faßten Informationen der	n schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,	
2. Bestimmte Ansprüche ha	ben sich als nicht rech	erchierbar erwlesen (si	ene Feld I).	
3. Mangelnde Einheitlichkeit	t der Erfindung (siehe F	eld II).		
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erflr	ndung			
X wird der vom Anmelder eing	gereichte Wortlaut geneh	ımlgt.		
wurde der Wortlaut von der	Behörde wie tolgt festge	esetzt:		
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung	e.			
wird der vom Anmelder eine	gereichte Wortlaut genet	nmiğt.		
wurde der Wortlaut nach Ri	egel 38.2b) in der in Feld e innerhalb eines Monati	I III angegebenen Fassur	ng von der Behörde festgesetzt. Der bsendung dieses Internationalen	
6. Folgende Abbildung der Zeichnungen	-	ssung zu veröffentlichen:	Abb, Nr. 1	
wie vom Anmelder vorgesc	hlagen		keine der Abb.	
weil der Anmelder selbst ke		_		
well diese Abbildung die Er	findung besserk nnzeic	nnet.		

4

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE 01/04903

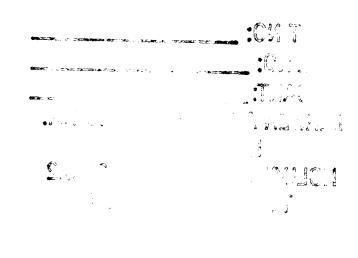
A WI ACCI	THE DUNC BED AND DUNCE CONTRACTO					
IPK 7	Fizierung des anmeldungsgegenstandes H01L21/66 B24B37/04 B24B49/0	0				
Nach der Ini	lamationales Palestideceifikation (IDK) oder nach der nationales Klas	sklikalinn und der IPK				
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK 8. RECHERCHIERTE GEBIETE						
	ter Mindestprütstoff (Klessifikationssystem und Klassifikationssymbo	le)				
IPK 7 B24B H01L						
Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen						
Während de	er internationaten Recherche konsultierte elektronische Dalenbank (N	ame der Datenbank und evit, verwendete S	Suchbegriffe)			
EPO-Internal						
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN					
Kalegoric*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	e der in Belracht kommenden Telle	Betr, Anspruch Nr.			
X	US 6 057 068 A (BURKE PETER A ET 2. Mai 2000 (2000-05-02) Spalte 6, Zeile 51 -Spalte 7, Zei		1,2,17			
A	US 6 159 075 A (ZHANG LIMING) 12. Dezember 2000 (2000-12-12) Zusammenfassung		1,17			
		·				
	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentramille				
 Besondere Kalegorien von angegebenen Veröffentlichungen : 'A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik demien, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldedatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldedatum veröffentlicht worden ist aber nicht als jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist anneldedatum veröffentlicht worden ist anneldedatum veröffentlichtung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweitelhaft erscheinen zu tassen, oder durch die das Veröffentlichungsadtum einer anderen im Recherchenbericht genannten veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) 'C' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Öffenbarung, eine Benutzung, eine Aussteltung oder andere Maßnahmen bezicht veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlichungen dieser Karegorie in Verbiffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichung die beanspruchte Erfindung veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichung die beanspruchte Erfindung veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichung die beanspruchte Erfindung veröffentlichung die ner der der ihr zugrundeliegenden von der außer der i						
Dalum des	Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts					
2	3. Januar 2003	30/01/2003				
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensleter Europäisches Patentami, P.B. 5818 Patentlaan 2						
NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo ni. Fax: (+31-70) 340-3016 Eschbach, D						

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröttentlichungen, die zur seiben Patentlamilie gehören

Internationales Aktenzeichen PCT/DE 01/04903

	echerchenbericht des Patentdokum		Datum der Veröffentlichung		Altglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US	6057068	A	02-05-2000	KEINE		
US	6159075	Α	12-12-2000	CN EP	1340210 T 1138071 A1	13-03-2002 04-10-2001
				WO	0127990 A1	19-04-2001



DOCKET NO:	P2000,0361
SERIAL NO: _	
APPLICANT: _	N. Dickenscheid et al.
LERNER AN	ID GREENBERG P.A.
P.0	. BOX 2480
HOLLYWOO	D, FLORIDA 33022
TEL. (S	954) 92 5-1100

• •